

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 5 月 26 日 (26.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/048408 A1(51) 国際特許分類⁷: H01R 12/06

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016847

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 12 日 (12.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-383002
2003 年 11 月 12 日 (12.11.2003) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 北陸電気
工業株式会社 (HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY
CO., LTD) [JP/JP]; 〒9392292 富山県上新川郡大沢野
町下大久保 3 1 5 8 番地 Toyama (JP).

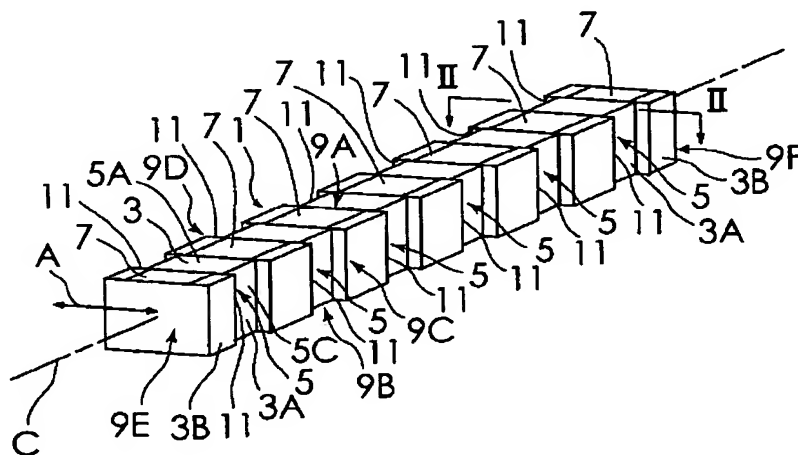
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡本 信二
(OKAMOTO, Shinji) [JP/JP]; 〒9392292 富山県上新川郡大沢野町下大久保 3 1 5 8 番地 北陸電気工業株式
会社内 Toyama (JP). 竹内 勝己 (TAKEUCHI, Katsumi)
[JP/JP]; 〒9392292 富山県上新川郡大沢野町下大久保
3 1 5 8 番地 北陸電気工業株式会社内 Toyama (JP).
野村 豊 (NOMURA, Yutaka) [JP/JP]; 〒9392292 富山
県上新川郡大沢野町下大久保 3 1 5 8 番地 北陸電
気工業株式会社内 Toyama (JP).(74) 代理人: 西浦 ▲嗣▼晴 (NISHIURA, Tsuguharu); 〒
1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 5 番 5 号 虎ノ門
3 4 M T ビル 9 階 西浦特許事務所 Tokyo (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: CONNECTOR CHIP AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: コネクタチップ及びその製造方法



(57) Abstract: There is provided a connector chip capable of easily connecting electrodes of a first circuit substrate with electrodes of a second circuit substrate while preventing shortcircuit between adjacent electrodes and without using a dedicated mounting device. An insulating base (3) has six faces (9A to 9F). Conductive routes (5) are formed at a predetermined interval on the four continuous faces (9A to 9D), in parallel to the remaining two faces (9E and 9F). An insulating layer (7) having a characteristic to repel molten solder is formed between the respective two adjacent conductive routes (5, 5) on the pair of faces (9A and 9B). The width dimension of the conductive route formation portion (3A) having the conductive route (5) formed, wherein the width orthogonally intersects the center line C, is made smaller than the width dimension of the non-conductive route formation portion (3B) where no conductive route (5) is formed.

[続葉有]



SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 隣接する電極間の短絡防止を図ることができ、しかも専用の実装機等を用いることなく容易に第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とを接続できるコネクタチップを提供する。6面9A~9Fを有する絶縁性基体3の連続する4つの面9A~9Dから構成される外周面上に、残りの2面9E, 9Fが対向する方向に所定の間隔を開けて外周面上を一周する複数の導電路5を形成する。一対の面9A, 9B上にそれぞれ位置する複数の導電路5の部分のうち隣接する2つの導電路5, 5の部分間に溶融半田をはじく性質を有する絶縁層7をそれぞれ形成する。導電路5が形成されている導電路形成部分3Aの中心線Cと直交する幅寸法を導電路5が形成されていない非導電路形成部分3Bの幅寸法よりも小さくする。